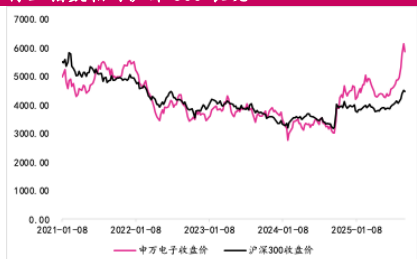


电子行业

2025年9月7日

涨幅 TOP5	最新	周涨跌幅	总市值
泓禧科技	27.30	42.34	20.20
苏大维格	33.67	31.06	87.43
腾景科技	92.77	30.20	120.00
杰华特	47.34	30.05	211.55
天通股份	12.10	27.37	149.25
跌幅 TOP5	最新	周涨跌幅	总市值
瑞芯微	198.00	-19.61	833.04
乐鑫科技	179.54	-17.49	281.34
波长光电	71.50	-16.43	82.74
东芯股份	99.00	-16.10	437.83
捷邦科技	108.50	-15.38	78.62

行业指数相对沪深300表现



相关报告

【金元电子】深度报告 20250623 光通信：AI 算力中心的神经网络

【金元电子】周报 20250725 世界人工智能大会，昇腾 384 超节点引领 AI 算力新纪元

【金元电子】周报 20250801 中美芯片博弈再升级，关注 H20 安全审查背后的国产替代机遇

【金元电子】周报 20250808 “China for China”战略已成为全球半导体产业的重要趋势

【金元电子】周报 20250815 光刻国产替代从 0 至 1 的“蓝海”，AI 基础设施投入的“红海”均值得关注

【金元电子】周报 20250822 DeepSeek 迎来第二次“杰文斯效应”，应用侧或加速落地

分析师：唐仁杰

执业证书编号：S0370524080002

电话：0755-83025184

邮箱：tangrj@jyzq.cn

行业周度点评报告

—光通信产业链趋势未改，Scale-up/Scale-out/Scale-across、OCS 助力互连性能提升

评级：增持（维持）

- **全行业：**本周上证指数下跌1.18%，深证成指下跌0.83%，沪深300指数下跌0.81%，申万电子板块下跌4.57%，电子行业在全行业中的涨跌幅排名为28/31。板块个股涨幅前五名分别为：泓禧科技、苏大维格、腾景科技、杰华特、天通股份；跌幅前五名分别为：瑞芯微、乐鑫科技、波长光电、东芯股份、捷邦科技。
- **电子行业：**本周电子行业整体周涨跌幅表现疲软，细分领域普遍下跌。二级行业中，半导体板块以-6.55%的跌幅领跌，其下分板块中，数字芯片设计以-9.13%的跌幅显著居前，对整体板块的拖累效应明显。元件板块整体下跌3.00%，其中被动元件跌幅达到3.91%，表现相对弱势。消费电子板块整体下跌2.43%，其中品牌消费电子表现尤为突出，跌幅达到4.25%，显示出该领域面临一定压力。光学光电子板块整体下跌2.82%，其中光学元件下跌3.40%，表现欠佳。电子化学品板块整体下跌1.46%，表现相对平稳，是二级行业中跌幅最小的。其他电子板块整体下跌3.20%，同样呈现下跌态势。总体来看，电子行业本周半导体板块表现最为疲弱，而电子化学品板块跌幅相对较小，不同板块间均呈现下跌但幅度差异较为明显。
- **行业要闻**
 - ◆ 特斯拉AI6芯片花落三星2nm
 - ◆ 瑞士加入全球AI竞赛，推出国家级开源大语言模型Apertus
 - ◆ 首届国际人形机器人奥运会在希腊开幕
 - ◆ 台积电加速建设1.4奈米产线，2028年进入量产
 - ◆ 苹果PC市场增幅领先，华为稳居平板市场首位
- **公司动态：**
 - ◆ 利通电子：2025年限制性股票激励计划摘要公告
 - ◆ 燕东微：持股5%以上股东减持股份计划公告
 - ◆ 派瑞股份：关于签订战略合作协议的公告
 - ◆ 安克创新：2025年半年度权益分派实施公告
 - ◆ ST长方：关于公开挂牌转让公司部分资产的进展公告
- **投资建议：**我们认为，从市场需求看，AI模型的参数规模和训练数据量仍在快速攀升，大模型已从数十亿参数跃升至数千亿甚至万亿级，训练所需的GPU节点从数百扩至数千。网络带宽正成为决定AI集群可扩展性的瓶颈，没有足够的互连带宽，GPU及ASIC等AI加速芯片的扩展效率大幅下降。当前来看，可插拔光模块提速至1.6T仍然是主流方案，且有望今年年底实现放量；另外，CPO技术方案正加速落地，并且在全光方案方面，已有头部云厂商开始尝试采购商用OCS设备融入数据中心，产业趋势仍然强劲。高速光模块及相关器件相关公司包括中际旭创、新易盛、天孚通信、华工科技等；布局CPO解决方案及相关有源、无源器件公司包括光库科技、源杰科技、鼎通科技、仕佳光子、长芯博创等；OC S相关零部件厂商包括光库科技、赛微电子、腾景科技等；空芯光纤、光缆包括长飞光纤、中天科技等。
- **风险提示：**1、下游需求不及预期：CSP 厂商需求走弱，AI 数据中心建设不及预期；2、产业链风险：当前主要厂商较为依赖产业链，上游产能或不及预期，导致收入不及预期；3、技术风险：CPO、OCS 为新技术，技术难度相对传统成熟可插拔光模块方案难度较大，前期投入及技术方案不成熟；4、政策风险：中美关税导致国内企业销售不及预期

目 录

一、核心观点3

二、行业跟踪9

三、行业新闻11

四、公司公告18

五、下周重要事件提示23

图表目录

图 1：计算性能增长远超互连性能3

图 2：高速率铜互连瓶颈约束 Scale-up 上限4

图 3：3D CPO 内部构造5

图 4：3D MEMS 微镜阵列及原理6

图 5：Twisted Torus 拓扑结构相较传统拓扑结构吞吐大幅提升7

图 6：本周各行业版块涨跌幅9

图 7：本周电子版块：子版块涨跌幅10

图 8：电子版块历史走势11

图 9：电子版块历史市盈率11

表 1：本周电子版块个股涨幅前五名9

表 2：本周电子版块个股跌幅前五名9

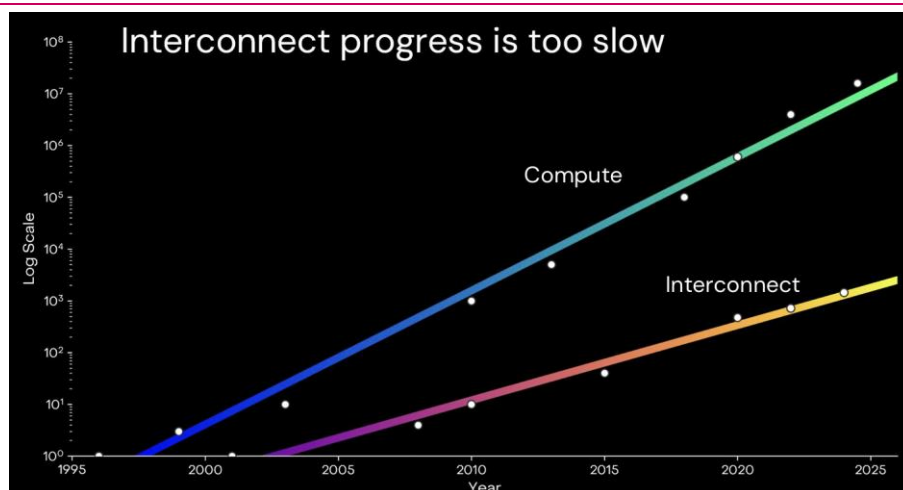
表 3：下周重要会议23

表 4：电子行业限售股解禁情况汇总（单位：万股）25

一、核心观点

光通信产业趋势未改，ASIC 或进一步加大基础设施投入。为何光通信如此重要？近年来，大规模人工智能模型的训练与推理对数据中心网络提出了前所未有的带宽和延迟要求。当前单卡算力（TFLOPS）性能持续增长，但是计算性能的增长远超互连性能的进度，互连成为了 AI 基础建设的“阿姆达尔短板”。

图 1：计算性能增长远超互连性能



数据来源：LightMatter，金元证券研究所

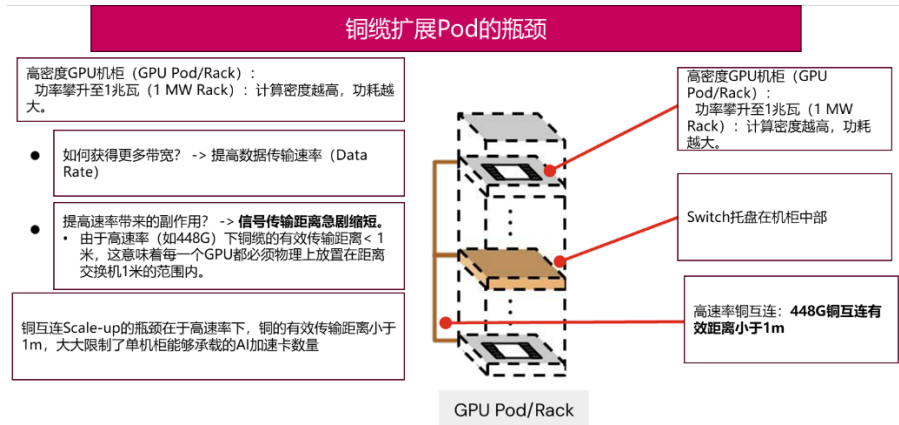
为了满足不断扩大的 AI 计算需求，数据中心需要在不同层面上扩展计算与互连能力。算力集群的扩张有三种方式：

- **Scale-up**(单机柜扩展，以 NVL72 为例，单机柜整合 18 个计算托盘，9 个交换托盘，单个计算托盘集成两张 GB200/300，每个 GB200/300 上有 2 个 B200、B300 计算芯片)：相当于将多张卡整合在一个计算节点，整个机柜如同整张“GPU”，共享内存。机柜内部的多张算力芯片通过 switch 芯片实现完全互连（即单卡与单卡之间直接交互）。Scale-Up 侧重片内/机内互连，需要极高带宽和低延迟的连接。Scale-up 的核心是在于单个机柜的高密度 GPU，为应对 AI 训练和大模型推理等计算密集型任务，数据中心采用高度集成化的设计。将数百甚至上千个 GPU 集中在一个机柜或一组机柜（称为一个 Pod）中，可以让它们协同工作，像一台巨型计算机一样解决问题。

Scale-up 面临的问题在于两个方面：1、功率极具攀升，计算密度越高，功耗越大。2、带宽、速率与传输距离的矛盾。提高带宽的方式是提高数据传输速率，当前机柜内主要通过铜互连（NVLink 为例）实现，铜的瓶颈在于由于高速率（如 448G）下铜缆的有效传输距离 < 1 米，这意味着每一个 GPU 都必须物理上放置在距离交换机 1 米的范围内。一个机柜的物理空间是有限的（通常是标准机架尺寸）。在交换机周围 1 米的“球体”空间内，能放入多少 GPU 加速卡/ASIC 和其散热装置是有一个物理上限

的。根据 lightmatter 研究，至 2027 年，铜互连下单机柜的承载上限为 144 张 GPU。为进一步 Scale-Up，光 I/O 被视为未来趋势，通过在芯片封装体内集成光互连（例如硅光子收发器），可以极大提升芯片“岸线”带宽（Beachfront Density），突破电气 I/O 物理极限

图 2：高速率铜互连瓶颈约束 Scale-up 上限

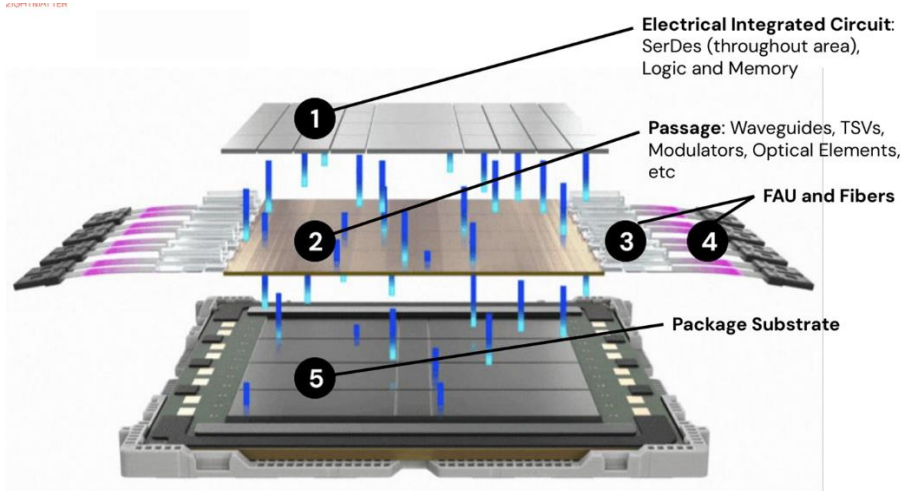


数据来源: LightMatter, 金元证券研究所

- **Scale-out (集群扩展):** 通过增加更多服务器节点并通过高速网络互联, 构建更大的单数据中心 AI 集群 (通常在同一机房/园区内)。典型如英伟达的 DGX SuperPOD (数百上千 GPU 通过 InfiniBand 或以太网交换机互连成一个训练集群)。

Scale-Out 关注机架间/集群内网络, 要求高端口数量、高带宽密度的交换结构, 以及微秒级低延迟通信。在此层面, 光纤连接早已成为主流, 例如 400 Gbps、800 Gbps、1.6Tbps 光模块通过 TOP (Top-of-Rack) 交换机连接各服务器。随着 AI 集群规模从数十节点扩大到上千甚至上万节点, 传统电背板和可插拔光模块面临严峻挑战, 需要处理成百上千条高速链路, 交换芯片容量突破 50 Tbps、100 Tbps, 光模块功耗和成本也随端口数剧增。共封装光学 CPO 由此进入集群网络层面的视野, 通过将光引擎直接与交换 ASIC 集成, 可以大幅提升交换机的总带宽和端口密度, 并降低每比特功耗。在 GTC 大会上, 黄仁勋曾举例称, 由 25 万颗 GPU 组成的 AI 网络中, 如果每 GPU 需配 6 个光模块连接交换机, 那么光模块本身的费用将为每 GPU 增加约 6000 美元功耗增加 180 W——整个系统将承受难以持续的成本和能耗。CPO 正是为缓解此问题而生, 通过取消箱体前面板大量可插拔模块, 改由低功耗的封装内光引擎直接输出光纤, 可带来量级上的能效改进。另一方面, 与 Scale-up 的痛点一致, 随着单芯片总线带宽飙升至 50 Tbps、100 Tbps 甚至更高, 传统 PCB 走线无法在合理功耗下支持 112 Gbaud、224 Gbaud 等速率信号传输, 因此当交换 ASIC 走向 102.4 Tbps 及 400 G/lane 时代, CPO 或将成为唯一可行方案。

图 3：3D CPO 内部构造



数据来源：LightMatter，金元证券研究所

- **Scale-Across (跨数据中心扩展)**：将地理上分散的多个数据中心互联成更大规模的“超级集群”（超级 AI 工厂），使其协同运行单一 AI 任务。这是应对单个机房功率和空间上限的新策略。当一个数据中心容纳 GPU 的能力达到极限时，就需要通过网络将多个场址连接成统一整体。Scale-Across 要求广域/园区间光互连，需要长距离传输下的超大带宽和极低传输延迟抖动。英伟达在 2025 年 8 月推出了 Spectrum-XGS Ethernet 解决方案，面向跨数据中心的 AI 网络互连，即通过在传统以太网中引入“第三种 Scale”，Scale-Across 技术实现跨城市乃至跨洲的 AI 工厂互联。Spectrum-XGS 结合了光子学技术和高级路由算法，可根据数据中心之间距离自动调整拥塞控制，实现地理分布集群中接近局域的通信性能。

引入 Scale-Across 后，多数据中心组成的 AI 集群在运行 NCCL 等 GPU 通信时性能几乎提升一倍，能够以可预测的低延迟运行跨地域的大规模分布式训练。在这一层面，光通信主要体现在数据中心互连(DCI)和广域骨干，例如使用相干 DWDM 光传输技术，在数十公里到数百公里的距离上提供 800 Gbps 乃至 1.6 Tbps 单波长容量，这方面的技术包括 Ciena 等提供的 1.6T 相干光模块和硅光子交换矩阵，以及英伟达 Spectrum X 系列中融合硅光子的 Quantum-2/X 等交换平台。

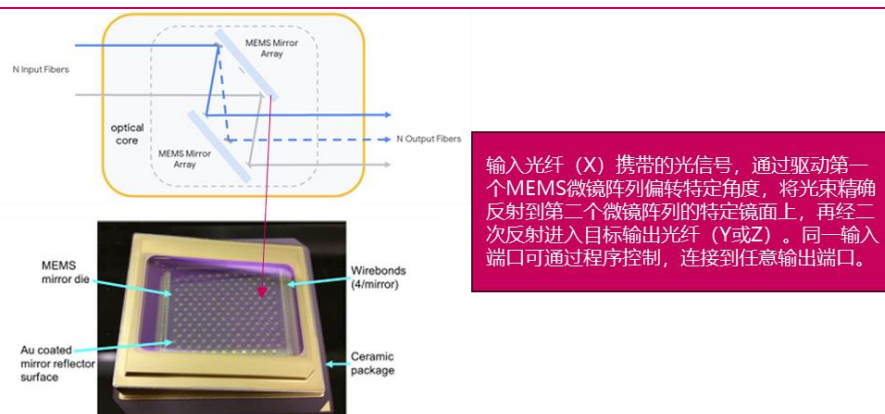
无论是 Scale-up\Scale-out 还是 Scale-across，从产业链发展来看，为了弥补数据速率、距离、功率及物理限制，均对光通信形成更强需求。除此之外，与 CPO 侧重于提升单设备的光接口能力不同，光电路交换 (Optical Circuit Switching, OCS) 着眼于整个网络架构层面，通过全光交换矩阵实现数据中心内部或跨数据中心的大规模动态互联。

OCS 的基本原理是使用光学开关单元直接在光层重构连接——光信号从输入端口射入，经光开关模块导引，直接从所需的输出端口射出，全程不经过电信号转换，这意味着在通信路径上消除了 O-E-O 转换的开销。OCS 本质上是一种物理层交换，可视作一个大容量光交叉连接(如 $N \times N$ 光矩阵，形似 Crossbar)。

只要光纤本身容量足够，OCS 几乎不限制每路连接的数据率，可轻松支持 400G、800G 甚至更高，不会像电子交换机那样受固定端口速率限制。多个并行光通道还能组成“光电路”汇聚超大流量（大象流），而不会出现电子交换中拥塞丢包等问题。由于无需缓冲重传或包转发，光路由本身几乎只有光在介质中传播的延迟，接近光速极限。例如数据中心尺度的 OCS 延迟通常仅几十纳秒到几微秒，远小于多跳电子网络累计的延迟。并且因为没有队列，不存在排队抖动，延迟极其稳定。这对同步算法的 AI 训练（如 All-Reduce 操作）大有裨益。

谷歌 TPU v4 超算系统通过引入光电路交换技术（OCS），实现了机器学习负载在规模、弹性与效率上的突破性进展。OCS 的核心在于利用 3D MEMS 微镜阵列动态重构光路，以毫秒级速度切换链路拓扑。其物理基础 Palomar OCS 支持 136×136 端口配置（含 8 个冗余端口），结合光学环行器实现单纤双向传输，显著降低线缆复杂度。这种设计使 4096 个 TPU v4 芯片得以组织为 64 个独立立方体单元（每单元 4×4×4=64 芯片），各单元通过 96 条光链路连接至 48 个分布式 OCS，形成全局可编程的 3D 环面网络。

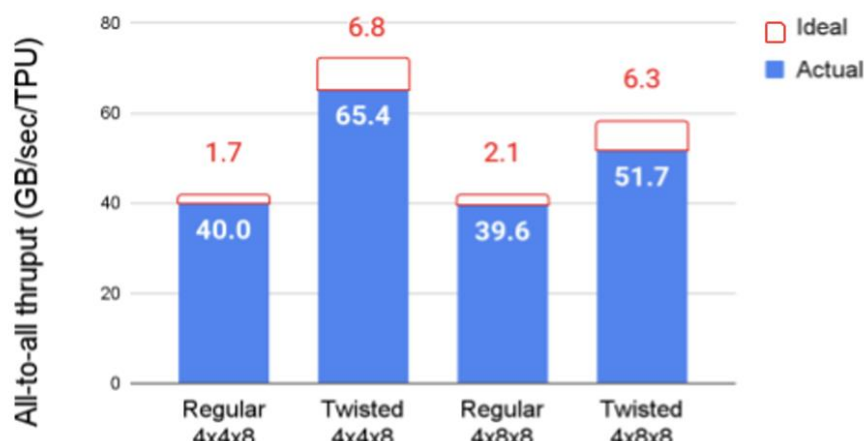
图 4：3D MEMS 微镜阵列及原理



数据来源：《Mission Apollo: Landing Optical Circuit Switching at Datacenter Scale》，金元证券研究所

拓扑灵活性进一步释放了性能潜力。OCS 支持在常规 3D 环面与扭转型环面（Twisted Torus）间动态切换。实测表明，在 4×4×8 芯片切片上，扭转型拓扑将全连接通信（all-to-all）吞吐提升 63%，克服了传统环面在二分带宽上的固有局限。这种能力直接转化为生产效益：通过协同优化拓扑与模型并行策略，大型语言模型（LLM）训练在 512 芯片规模上获得 2.3 倍加速。

图 5: Twisted Torus 拓扑结构相较传统拓扑结构吞吐大幅提升



数据来源:《TPUv4: An Optically Reconfigurable Supercomputer for Machine Learning with Hardware Support for Embeddings》, 金元证券研究所

当然, OCS 也有自身局限, 主要是交换粒度与重配置时间。OCS 建立的是持续的光电路而非数据报文逐包交换, 因此适合承载长时间、大容量的数据流, 不擅长处理短报文或高度动态的流量模式。如果通信模式频繁变化, OCS 需要不停地重配置光路, 而传统机械式/液晶式光开关的切换时间往往在毫秒甚至秒级。此外, OCS 通常不具备缓冲和错误恢复能力, 需要在上层协议或应用上配合调度。因此, 实际中 OCS 常与电子交换网络结合, 形成混合网络: 小流和突发流量走常规交换机, 大流和周期流量走 OCS 直通路径。借助 SDN 控制器智能调度, 动态为大流量分配光电路, 从而优化整体网络性能。对于 AI 训练这类可预测的批处理通信 (例如每一轮迭代都要在 GPU 间做梯度汇总, 全局通信模式相对稳定), OCS 非常契合需求, 可以在训练开始时为其配置优化的光路拓扑, 整个任务期间保持不变或在阶段切换时调整, 既保证高带宽低延迟, 又无需频繁切换。

我们认为, 从市场需求看, AI 模型的参数规模和训练数据量仍在快速攀升, 大模型已从数十亿参数跃升至数千亿甚至万亿级, 训练所需的 GPU 节点从数百扩至数千。网络带宽正成为决定 AI 集群可扩展性的瓶颈, 没有足够的互连带宽, GPU 及 ASIC 等 AI 加速芯片的扩展效率大幅下降。当前来看, 可插拔光模块提速至 1.6T 仍然是主流方案, 且有望今年年底实现放量; 另外, CPO 技术方案正加速落地, 并且在全光方案方面, 已有头部云厂商开始尝试采购商用 OCS 设备融入数据中心, 产业趋势仍然强劲。高速光模块及相关器件相关公司包括中际旭创、新易盛、天孚通信、华工科技等; 布局 CPO 解决方案及相关有源、无源器件公司包括光库科技、源杰科技、鼎通科技、仕佳光子、长芯博创等; OCS 相关零部件厂商包括光库科技、赛微电子、腾景科技等; 空芯光纤、光缆包括长飞光纤、中天科技等。

风险提示：

1、下游需求不及预期：

GSP 厂商需求走弱，AI 数据中心建设不及预期；

2、产业链风险：

当前主要厂商较为依赖产业链，上游产能或不及预期，导致收入不及预期

3、技术风险：

CP0、OCS 为新技术，技术难度相对传统成熟可插拔光模块方案难度较大，前期投入及技术方案不成熟

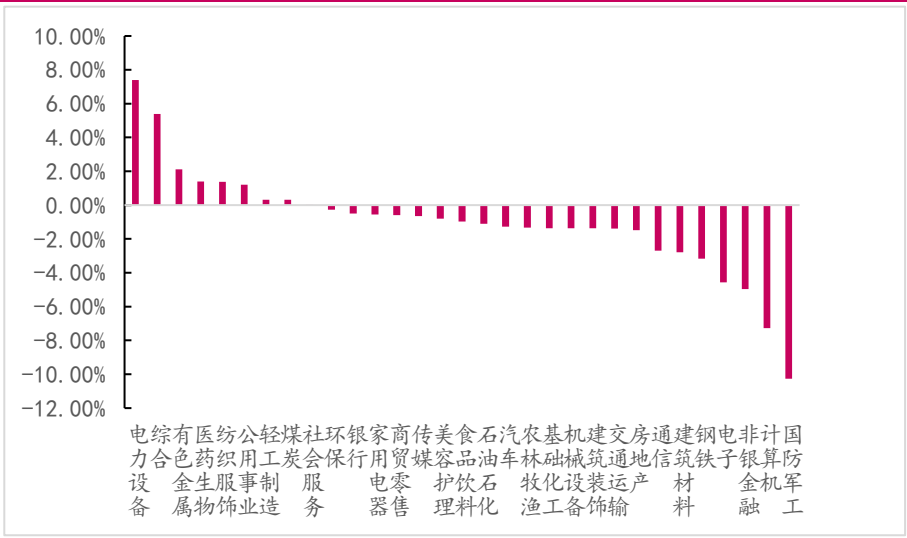
4、政策风险：

中美关税导致国内企业销售不及预期

二、行业跟踪

全行业：本周（2025.09.01–2025.09.05）上证指数下跌 1.18%，深证成指下跌 0.83%，沪深 300 指数下跌 0.81%，申万电子板块下跌 4.57%，电子行业在全行业中的涨跌幅排名为 28/31。板块个股涨幅前五名分别为：泓禧科技、苏大维格、腾景科技、杰华特、天通股份；跌幅前五名分别为：瑞芯微、乐鑫科技、波长光电、东芯股份、捷邦科技。

图 6：本周各行业板块涨跌幅



数据来源：Choice，金元证券研究所

表 1：本周电子板块个股涨幅前五名

证券代码	证券简称	周涨跌幅	收盘价（元）	周最低价（元）	周最高价（元）	周换手率	周成交量（万手）	周成交金额（亿元）
871857.BJ	泓禧科技	42.34	27.30	19.06	27.30	17.41	12.89	2.84
300331.SZ	苏大维格	31.06	33.67	25.18	34.57	152.05	319.64	96.54
688195.SH	腾景科技	30.20	92.77	69.08	95.98	67.76	87.65	74.24
688141.SH	杰华特	30.05	47.34	36.30	47.80	72.59	191.60	79.35
600330.SH	天通股份	27.37	12.10	9.48	12.10	105.62	1302.77	141.90

数据来源：Choice，金元证券研究所

表 2：本周电子板块个股跌幅前五名

证券代码	证券简称	周涨跌幅	收盘价（元）	周最低价（元）	周最高价（元）	周换手率	周成交量（万手）	周成交金额（亿元）
603893.SH	瑞芯微	-19.61	198.00	191.28	249.99	24.43	102.77	220.22
688018.SH	乐鑫科技	-17.49	179.54	172.75	225.60	21.67	33.96	66.33
301421.SZ	波长光电	-16.43	71.50	68.62	86.52	53.10	24.59	19.00
688110.SH	东芯股份	-16.10	99.00	93.66	136.00	30.01	132.72	147.19
301326.SZ	捷邦科技	-15.38	108.50	101.22	130.39	66.55	18.01	20.44

数据来源：Choice，金元证券研究所

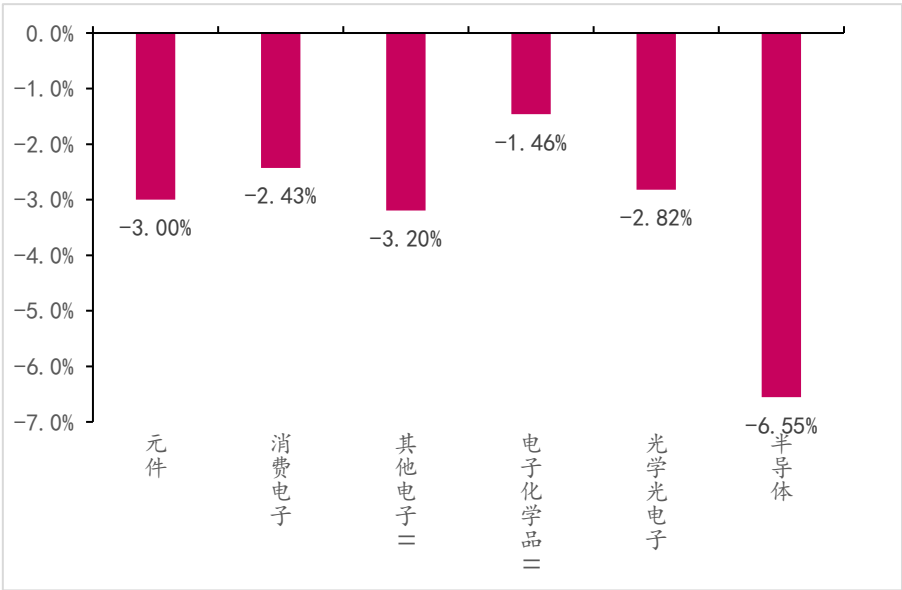
电子行业：本周（2025.09.01–2025.09.05）电子行业整体周涨跌幅表现疲软，

请务必仔细阅读本报告最后部分的免责声明

曙光在前 金元在先

细分领域普遍下跌。二级行业中，半导体板块以 - 6.55% 的跌幅领跌，其下分板块中，数字芯片设计以 - 9.13% 的跌幅显著居前，对整体板块的拖累效应明显。元件板块整体下跌 3.00%，其中被动元件跌幅达到 3.91%，表现相对弱势。消费电子板块整体下跌 2.43%，其中品牌消费电子表现尤为突出，跌幅达到 4.25%，显示出该领域面临一定压力。光学光电子板块整体下跌 2.82%，其中光学元件下跌 3.40%，表现欠佳。电子化学品板块整体下跌 1.46%，表现相对平稳，是二级行业中跌幅最小的。其他电子板块整体下跌 3.20%，同样呈现下跌态势。总体来看，电子行业本周半导体板块表现最为疲弱，而电子化学品板块跌幅相对较小，不同板块间均呈现下跌但幅度差异较为明显。

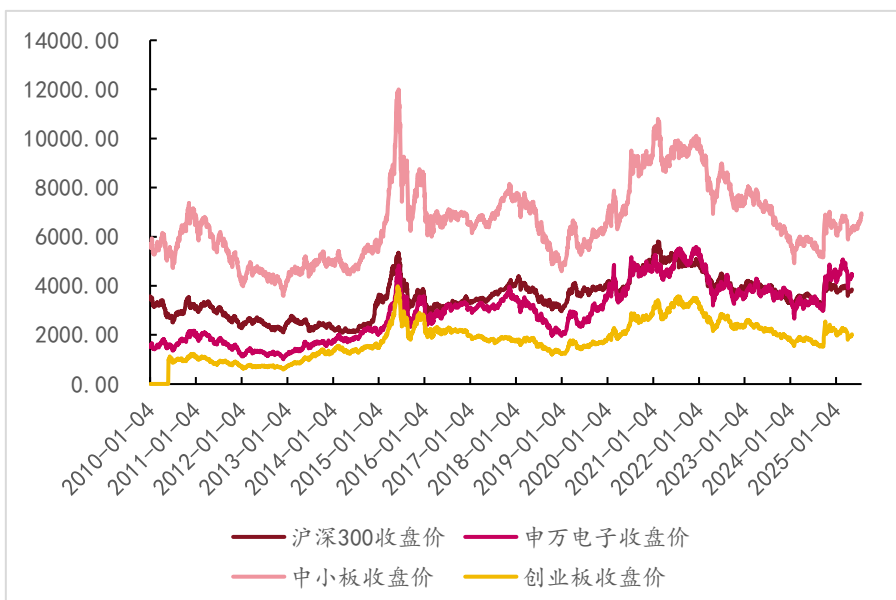
图 7：本周电子版块：子版块涨跌幅



申万二级行业	周涨跌幅	申万三级行业	周涨跌幅
半导体	-6.55%	分立器件	-2.71%
		半导体材料	-3.93%
		数字芯片设计	-9.13%
		模拟芯片设计	-5.86%
		集成电路封测	-5.71%
		半导体设备	-5.26%
元件	-3.00%	印制电路板	-2.80%
		被动元件	-3.91%
光学光电子	-2.82%	面板	-2.81%
		LED	-2.22%
		光学元件	-3.40%
消费电子	-2.43%	品牌消费电子	-4.25%
		消费电子零部件及组装	-2.22%
电子化学品	-1.46%	电子化学品 III	-1.46%
其他电子	-3.20%	其他电子 III	-3.20%

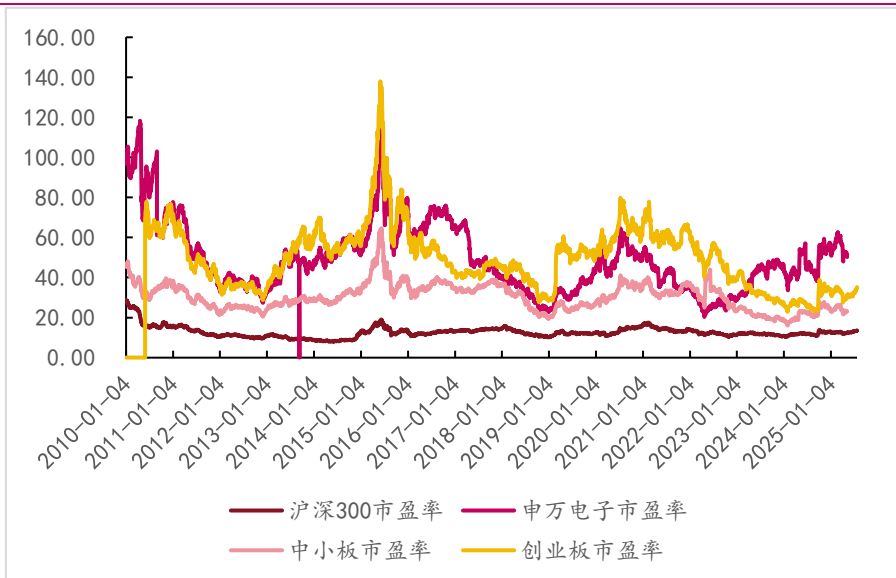
数据来源: Choice, 金元证券研究所

图 8: 电子板块历史走势



数据来源: Choice, 金元证券研究所

图 9: 电子板块历史市盈率



数据来源: Choice, 金元证券研究所

三、行业新闻

台积电亚利桑那工业再生水厂动土, 2028 年启用运转

9月1日科技新报消息, 台积电美国亚利桑那工业再生水厂动土兴建, 预计2028 年启用运转。初期运作时, 厂房的水回收率达85%, 并计划逐步提升至90% 甚至更高, 目标实现“近零废水排放”, 即每一滴水几乎都可以循环再利用。

台积电指出，亚利桑那工业再生水厂占地15英亩，这座厂展现台积电对永续经营的承诺，将把工业废水转化为符合芯片制造过程所要求的“超纯水”标准。台积电表示，超纯水主要用于清除可能导致半导体晶圆缺陷的微小颗粒，尤其在生产先进技术芯片时更为重要，例如亚利桑那晶圆厂所制造的4纳米芯片。台积电发布的讯息中，子公司TSMC Arizona总经理卡斯塔那里斯（Rose Castanares）说，台积电会选择在凤凰城设立美国营运据点，其中一个重要原因是州政府与市政府周密且审慎的规划，包括制定一项为期百年的供水计画。

英特尔将获得57亿美元“美国政府投资”，白宫称细节“正在敲定”

9月1日电子工程专辑消息，近日，美国芯片巨头英特尔首席财务官大卫·辛瑟（David Zinser）表示，该公司已从美国政府获得57亿美元投资。辛瑟在8月28日的投资者会议上承认了这笔投资。这笔投资是白宫上周五决定收购这家陷入困境的计算机芯片公司9.9%股份的一部分。特朗普政府于8月25日与英特尔达成协议，通过向英特尔投资89亿美元，收购其9.9%的股份，使美国政府成为其大股东。这89亿美元包括根据拜登政府《芯片与科学法案》授予英特尔但尚未支付的57亿美元补贴，以及另一笔32亿美元的“安全飞地计划”（Secure Enclave Program）资助。这笔资金认购英特尔4.333亿股普通股（占股9.9%），按每股20.47美元计算。加上英特尔此前已获得的22亿美元补贴，美国政府对英特尔的总投资达111亿美元。

Amkor投资20 亿“换地建厂”，Peoria 取代Vistancia 成新基地

9月1日科技新报消息，Amkor Technology, Inc.，全球领先的半导体封装与测试服务供应商，宣布调整其在亚利桑那州新建先进封装与测试厂的选址计划。根据官方新闻稿，新厂将落脚于亚利桑那州Peoria 市北部的Peoria Innovation Core，用地面积达104 英亩。Peoria 市议会已一致通过土地交换及修订后的开发协议，允许Amkor 以此基地交换原先规划于Five North at Vistancia 社区的56 英亩土地。新厂预计将于近日动工，并在2028 年初正式投产。Amkor 总裁及执行长Giel Rutten 表示：“身为美国最大的先进封装公司，Amkor 很自豪能够投资美国半导体制造，并强化美国半导体供应链。”Peoria 市长Jason Beck 则指出，这项合作可为社区带来20 亿美元投资与2,000 个就业机会，同时强化Peoria 在美国关键半导体供应链中的战略地位。

兼具DRAM、NAND 优势！新内存“UltraRAM”已准备投入量产

9月1日科技新报消息，革结合DRAM、NAND 优点的新型内存“UltraRAM”已经大幅推进其商业化进程。综合外媒报导，UltraRAM 的开发公司Quinas Technology 过去一年持续与先进晶圆产品制造商IQE 合作，致力将UltraRAM 内存的制程推进到工业化规模。外媒Blocks & Files、Tom’s Hardware 报导指出，这项合作已经成功，而UltraRAM 被视为结合DRAM 与NAND 优点的新型内存，具备DRAM 般的高速运作、耐用度比NAND 高4,000 倍、低于1 飞焦耳的超低切换能耗，及资料保存能力长达千年，如今正迈向量产。报导指出，该设计之所以大幅进展，主要是因为采用锑化镓（gallium antimonide）与锑化铝（Aluminium antimonide）的磊晶技术获得突破，而且为全球首创，将帮助UltraRAM 真正进入量产。

特斯拉AI6芯片花落三星2nm

9月1日电子工程专辑消息，韩国媒体报道，电动汽车领域巨头特斯拉与晶圆代工龙头三星电子的合作细节进一步明晰，特斯拉下一代核心芯片“AI6”将正式采用三星第二代2 纳米（SF2P）工艺。作为三星计划于2026 年量产的先进工艺技术，SF2P 是其在2 纳米赛道的关键迭代产品，相较于2025 年下半年即将量产的第一代2nm（SF2）工艺，实现了性能、功耗与尺寸的“三重优化”。据三星晶圆代工事业部披露，SF2P 工艺在性能上提升12%，可更好支撑高算力场景需求；功耗降低25%，契合智能汽车、AI 设备对低能耗的要求；芯片面积缩小约8%，能在有限空间内集成更多晶体管，进一步提升芯片运算效率。

瑞士加入全球AI竞赛，推出国家级开源大语言模型 Apertus

9月02日IT之家消息，全球 AI 竞赛再添新参与者，这次是一整个国家。瑞士正式发布了国家级开源大语言模型Apertus，希望其能成为 OpenAI 等企业所提供模型的替代选择。“Apertus”源自拉丁语，意为“开放”，该模型由瑞士洛桑联邦理工学院、苏黎世联邦理工学院以及瑞士国家超级计算中心联合研发，这三家机构均为公共机构。“当前，Apertus 是领先的公共 AI 模型：由公立机构打造，服务于公共利益。这是我们迄今为止最有力的证明——AI 完全可以成为像公路、供水、供电一样的公共基础设施。”推动 AI 成为公共基础设施的核心倡导者约书亚·谭表示。瑞士研发团队将 Apertus 设计为完全开源模式，用户可查看其训练过程的各个环节。除模型本身外，团队还同步公开了训练过程的完整文档、源代码，以及所使用的数据集。Apertus 的研发严格遵循瑞士数据保护法与版权法，对于希望遵守欧洲相关法规的企业而言，它或许是更优选择之一。瑞士银行家协会此前曾指出，本土研发的大语言模型具有“巨大的长期潜力”，因为这类模型能更好地契合瑞士严格的本地数据保护法规与银行保密制度。目前，瑞士各银行已在使用其他 AI 模型满足业务需求，未来是否会转向 Apertus，仍有待观察。

首届国际人形机器人奥运会在希腊开幕

9月02日IT之家消息，据央视财经今日报道，来自全球多家企业的人形机器人近日齐聚奥运会的发源地希腊奥林匹亚，参加国际人形机器人奥林匹克运动会，这场运动会以奥运会为灵感，旨在展示人形机器人的技能与智慧。报道称，参加人形机器人运动会的相关专家表示，近两年，生成式人工智能模型取得飞速发展，已在许多领域展开实际应用，而人形机器人应用却落后很多，其中主要原因在于人形机器人的训练材料更加复杂，更难获得。不过，也有一些专家对此十分乐观，他们认为，我们现在已经处于机器人新时代的前夜。

英伟达暂时性缩减 GeForce RTX 5060 家族显卡 GPU 供应规模

9月02日IT之家消息，渠道消息源博板堂今日表示，英伟达近期暂时性削减 GeForce RTX 5060 / RTX 5060 Ti 8GB 两款显卡的 GPU 供应规模，对下游 AIC 显卡制造商的采购需求进行砍单。消息指出英伟达针对 RTX 5060 Ti 8 GB 显卡的 AIC 采购计划减少 15% 交付量，而针对 RTX 5060 更是暂砍掉三成左右。预计这两款显卡短期内供应将更为紧张，带动产品价格企稳回升。

英特尔 Nova Lake-S 桌面处理器 52 核双计算芯粒版本存在得到确认

9月02日IT之家消息，参考 X 平台用户 @meng59739449 的动态，英特尔将在 2026 年推出的新架构桌面处理器 "Nova Lake-S" 的双计算芯粒 52 核版本的相关信息出现在了 NBD 平台上。"Nova Lake-S" 的单计算芯粒 28 核版本此前已现身。此次出现的信息记录与 FCLGA1954 平台的 Jig 有关。"Nova Lake-S" 将使用新的 FCLGA1954 插槽，不过该插槽的长宽数据与现有 "Arrow Lake-S" 的 FCLGA1851 完全一致。"Nova Lake-S" 的 52 核心版本将采用 16P + 32E + 4LPE 的核心设计，大致布局则会为 (8P+16E) + (8P+16E) + 4LPE，即由两颗均包含 8 个性能核与 16 个能效核的计算芯粒和处于非核心芯粒上的另外四颗低功耗能效核组成。另有消息称，英特尔在 "Nova Lake-S" 上将制造包含 LLC 缓存和不包含 LLC 缓存的两种不同版本 8P+16E 计算芯粒。

台积电加速建设 1.4 奈米产线，2028 年进入量产

9月3日科技新报消息，晶圆代工龙头台积电加速迈向下代制程，准备超前原定日程，兴建首座 1.4 奈米 (A14) 晶圆厂。目的为扩大台积电先进半导体领先地位，预定投资高达新台币 1.5 兆元，约 490 亿美元，突显台积电维持半导体产业领先地位的决心与实力。Wccfttech 报导，新 1.4 奈米晶圆厂名为「Fab 25」，位于台湾中部科学园区，毗邻台中市。有四座独立厂房，台积电目标 2027 年底前，首座厂房启动 1.4 奈米试产。台积电已提前知会关键供应商，确保加速准备 1.4 奈米精密设备。照时程有望 2028 年下半年全面投入 1.4 奈米晶片量产。1.4 奈米将为晶片产业带来显著进步，高达 15% 性能提升，功耗达 30% 进步，对追求更高效率和更长电池寿命的电子产品而言，无疑是一大福音。Fab 25 三座厂房也专注 1.4 奈米晶片生产，台积电目光也投向更先进 1 奈米。1 奈米试产时程尚未公布，却预示台积电的雄心壮志。

2025 DRAM 营收季增 17.1%，SK 海力士市占扩大、台厂成长力道强劲

9月3日科技新报消息，TrendForce 表示，2025 年第二季 DRAM 产业因一般型 DRAM 合约价上涨、出货量显著增长，加上 HBM 出货规模扩张，整体营收为 316.3 亿美元，季成长 17.1%。平均销售单价 (ASP) 随着 PC OEM、智能手机、CSP 业者的采购动能增温，加速 DRAM 原厂库存去化，多数产品的合约价也因此止跌翻涨。观察主要供应商第二季营收表现，SK 海力士 (SK hynix) 位元出货量优于目标计划，但因相对低价的 DDR4 出货比重提升，抑制整体 ASP 成长幅度，营收接近 122.3 亿美元，季增达 25.8%，市占上升至 38.7%，蝉联第一名。

英特尔注册软体定义核心专利，以组合虚拟大核心提升单执行绪效能

9月3日科技新报消息，处理器大厂英特尔 (Intel) 近日取得「软体定义核心」(Software Defined Supercore, SDC) 专利，概念是软体结合多核心，组成一个虚拟且超宽广的「超级大核心」。Tom's Hardware 报导，新技术目标是在具备足够偕同工作量的特定应用，显著提升单执行绪的性能表现。若该技术可以成功达成，未来英特尔的中央处理器 (CPU) 有望在选定的应用程序中提供更为出色的单执行绪性能。然而，目前这仅是一项专利，未来是否真正用于产品，仍是未知数。英特尔 SDC 目的为协同运作，将两个或更多实体 CPU 核心

结合，如单一高性能虚拟核心。机制是将单一执行绪指令拆分成独立区块，不同实体核心平行运算。为了确保程式的原始执行顺序不受影响，系统会用专门同步与资料传输指令协调。

先进制程成本提升与海外扩产压力，台积电对大客户开始启动涨价潮

9月3日科技新报消息，台积电正准备在未来几年内实施大规模的价格调整，该计画预计将对其主要客户如苹果、NVIDIA 等科技大厂的晶片生产成本产生显著影响。而带动此波涨价的关键，在于台积电不断攀升的生产成本，特别是其在美国亚利桑那州的庞大投资，以及其在晶圆代工市场上无可匹敌的独占地位。报导指出，台积电已计划从 2026 年起，对包括即将于 2025 年底量产的 2 奈米制程在内的 5 奈米以下先进制程，调涨价格 5% 至 10%。目前，3 奈米晶圆的价格约为每片 2 万美元，而 2 奈米预计将至少高出 50%，达到每片 3 万美元以上，且未来还有可能进一步上涨。台积电也已提前将此价格策略知会其主要客户。

为避免欧盟罚款，消息称微软拟将 Teams 应用从 Office 套件中拆分出来

9月04日彭博社消息，微软有望避免欧盟对其视频会议应用 Teams 涉嫌非法捆绑销售的高额反垄断罚款，因为欧盟对微软提出的和解方案给予了积极反馈。知情人士透露，欧盟监管机构将接受微软承诺，将 Teams 从 Office 套件中拆分出来。这些人士指出，在市场测试中，竞争对手和客户没有提出重大反对意见。欧盟委员会此前曾警告微软，自 2019 年以来，其滥用市场地位让 Teams 获得了不公平的竞争优势。根据和解方案，微软同意将把 Teams 与 Office 365 和 Microsoft 365 套件分开销售，并承诺对不含 Teams 的套件降价，同时改善竞争软件在微软服务上的兼容性。知情人士称，方案仍处于草案阶段，具体时间可能会调整。

苹果 PC 市场增幅领先，华为稳居平板市场首位

9月04日IT之家消息，市场调查机构 Canalys 发布博文，报告称受持续的消费补贴、国有企业和政府强劲采购活动拉动，2025 年第二季度中国大陆 PC 市场（不含平板）出货量为 1020 万台，同比增长 12%。在 AI PC 方面，2025 年第 2 季度 AI PC 占整体 PC 市场的 28%，表明消费者和企业对高性能硬件需求的上升。该机构预测中国大陆 PC 市场 2025 年将增长 2%，2026 年将增长 3%，AI PC 渗透率预计从 2025 年的 34% 升至 2026 年的 52%，到 2029 年底大中华区 AI PC 累计出货量有望达 1.07 亿台。平板方面，2025 年第 2 季度平板电脑出货量 910 万台，同比增长 18%。该机构认为在 2025 年上半年受补贴刺激，平板市场 2025 年全年出货量有望增长至 3400 万台，同比增长 8%，但 2026 年预计下降至 3100 万台，降幅为 9%。

三星电机研发“连续光学变焦”手机相机，优先供应小米等中国厂商

9月04日IT之家消息，韩媒 The Elec 报道称三星电机正优先为小米等中国手机厂商，研发可在不同变焦倍率下保持高画质的“连续光学变焦”长焦相机模组。连续光学变焦是一种相机镜头技术，不同于传统 5 倍或 10 倍固定倍率的折叠变焦方案，可在多个焦段间平滑变换焦距，从而在不同倍率下都能保持高画质。在技术原理上，连续光学变焦将镜头分为两个或以上镜组，通过独

立移动部分镜组，来实现连续调节焦距。相比之下，传统折叠变焦模組的焦距是固定的，仅在特定倍率提供光学变焦，其余倍率依赖数码变焦，画质会明显下降。例如，现有的 100 倍变焦功能，大部分区间实际是数码放大。不过，连续变焦的实现难度较高。由于需要更长的镜头移动行程，模組内部的驱动结构更复杂，同时必须解决镜组间光轴的精准对齐以及机身厚度增加的问题。此外消息称三星电机优先面向小米等中国厂商供货，原因在于中国品牌在采用新技术方面通常更为积极，愿意率先测试和验证新规格。

谷歌正打破 TPU 完全自托管局面，强化与英伟达 AI 芯片竞争

9月04日IT之家消息，谷歌自研 AI 芯片 TPU 张量处理器已有多年的历史、历经数次迭代，其不仅支持谷歌自身 AI 业务，还以 Google Cloud 上的云端算力形式提供给 OpenAI 等合作方。谷歌的 TPU 芯片迄今为止仍然完全在自家数据中心托管，未部署到外部物理环境中。不过根据外媒 The Information 的报道，这一局面即将被打破。最新报道指出，谷歌近期正与主要对外租赁英伟达 AI GPU 的小型云服务供应商展开谈判，希望这些企业在数据中心也托管部署谷歌的 TPU 芯片。谷歌已与至少一家合作方就此达成协议。对于谷歌而言，这可能意味着其 AI 战略的一次重大转型：谷歌准备以第一大 AI ASIC 企业的地位挑战英伟达 GPU 在 AI 芯片领域的霸权，而外部部署 TPU 也能让谷歌 Tensor 算力摆脱有限的自建数据中心能力的束缚。

华为史上最大 MateTV 单核性能提升 490%

9月04日IT之家消息，在今日的华为 Mate XTs 非凡大师及全场景新品发布会上，华为正式公布了史上最大 Mate —— 华为智慧屏 MateTV。据介绍，华为智慧屏 MateTV 在性能方面相比以往的智慧屏迎来大幅提升，搭载旗舰手机级芯片 + 独立画质芯片。从华为 PPT 中放出的对比，华为智慧屏 MateTV 首次把旗舰手机级芯片装进智慧屏，单核能力提升 490%、多核能力提升 360%、GPU 能力提升 251%。在更高性能的芯片加持下，华为智慧屏 MateTV 可以实现应用秒开、多任务秒切换，以及更加炫酷的 3D 光影 UI 效果，还有视频 AI 超分辨率、游戏高帧率等。

字节跳动回应“分拆芯片团队”，业务主体没有变化，仅切换飞书租户

9月04日IT之家消息，近日，字节整个芯片团队权限被注销，业务从集团独立，变更至新的主体且未提供 N+1 的赔偿。报道表示，此举涉及整个芯片团队，不限于 AI 芯片业务，重点是在做一些表面上与字节切割的动作，以后在一家新加坡公司的壳子下运行。对此，字节相关负责人回应称，该消息是谣言，字节芯片业务的主体一直没有变化，这次只是切换飞书租户，外界关于裁员、独立、变更主体等各种过度解读不实。

台积电广发英雄帖，拟以 12 吋 SiC 解决矽中介层、载板散热问题

9月5日科技新报消息，碳化矽 (SiC) 有望成为台湾厂商的新出海口！随着 AI 运算带来更高的热能负荷，现有散热材料已难以满足需求，导致晶片性能下滑。半导体业界传出，台积电正广发英雄帖，号召设备厂与化合物半导体相关厂商参与，计划将 12 吋单晶碳化矽应用于散热载板，取代传统的氧化铝、蓝宝石基板或陶瓷基板。过去碳化矽主要应用在功率元件 (Power Devices)、

车用及储能领域，如今已进入新发展阶段，例如在 AR 智慧眼镜（AR Lens）镜片及高阶 3D IC 封装中，需要碳化矽作为散热材料，尤其是应用在散热载板这个部分。其中，3D IC 封装的碳化矽应用有两个可能方向，首先是散热载板，将以「导电型 SiC」优先测试；下一阶段则可能在矽中介层（Silicon Interposer）导入半绝缘型 SiC。

利空连发寒武纪股价再重挫，距高点跌逾 20%

9月5日科技新报消息，前一度登顶 A 股股王的中国人工智慧晶片龙头寒武纪，近日股价持续下跌，4 日盘中一度重挫 14%，距最高点已跌逾 20%，失去股王地位。相关利空消息包括上交所调整科创 50 指数权重，以及阿里云相关人士澄清采购晶片消息不实。综合中媒界面新闻、每日经济新闻报导，4 日 A 股开盘，寒武纪再次大跌，盘中一度跌逾 14%，截至发稿前，股价最低至 1,208 人民币（约新台币 5,194 元）。寒武纪从 8 月 28 日取代贵州茅台成为第一高价股后，经历多日调整，已从最高价 1,595.88 元回撤超过 20%。报导指出，股价下跌与上海证券交易所决定调整科创 50 等指数样本有关。寒武纪在科创 50 指数中的权重，将从约 15% 降至 10%。

联电 8 月营收月减 4.39%，累计前 8 个月营收年增 1.86%

9月5日科技新报消息，晶圆代工大厂联电公布 8 月份营收，金额为新台币 191.6 亿元，与 7 月份的 200.4 亿元相较，减少 4.39%。与 2024 年同期的 206.45 亿元相较，减少 7.20%。累计，2025 年前 8 个月营收来到 1,558.16 亿元，较 2024 年同期增加 1.86%。根据联电上一季法说会上表示，展望第三季，联电对晶圆出货量的预期仍是略有增加。然而，公司也预警指出，不利的汇率变动将导致以新台币计算的营收减少。这再次突显外汇波动对公司财务表现的潜在影响。而面对总体经济与地缘政治的复杂挑战，联电将密切关注市场短期内的不确定性与风险，特别是美国关税政策的持续受到关注。

日 Resonac 成立先进封装技术联盟，抢攻方形基板中介层商机

9月5日科技新报消息，日本半导体材料制造商 Resonac 宣布成立由 27 间全球企业组成的联盟「JOINT3」，目标是开发先进的晶片封装技术。该联盟企业来自美国、日本、新加坡多国的材料制造商、设备供应商与晶片设计公司，如应用材料、东京威力科创。Resonac 在声明中表示，联盟将共同开发材料、设备与设计工具，用于制作以有机材料方形基板打造的中介层（interposers），并利用 515 x 510 mm 作为评估试作产线。Resonac 半导体材料事业的技术长 Hidenori Abe 表示，JOINT3 是一个「让材料制造商、设备供应商与设计公司实际演练，开发用于大尺寸基板制造中介层的材料、设备与技术的场域」。

DDR4 市场需求强劲，拉抬南亚科 8 月营收年增 141% 刺激股价大涨

9月5日科技新报消息，记忆体大厂南亚科受惠于 DDR4 持续供不应求的影响，缴出 2025 年 8 月份自结合并营收为新台币 67.63 亿元，较上月增加 26.35%，较 2024 年同期大幅增加 141.32% 的佳绩，也创下 2022 年 3 月以来的单月新高纪录，也是连续第七个月成长。累计，合并营收为来到 298.29 亿元，较 2024 年同期增加 19.45%。根据市调机构根据 TrendForce 最新调

查，2025 年下半年 DDR4 市场处于持续供不应求与价格强势上涨态势，由于 server 的刚性订单挤压 PC 和 consumer 市场供应，PC OEM 不得不加速导入 DDR5 方案，consumer 厂商则面临高价、难以取得物料的挑战，而 DDR 市场供需紧张也推升 Mobile DRAM 合约价格，第三季 LPDDR4X 涨幅为近十年单季最大。

四、公司公告

苏大维格：关于签署股权收购意向协议的公告

公司9月1日发布公告，公司于近日与常州维普部分股东蒋开、刘建明、张彦鹏、刘庄、常州市地平线创业投资发展合伙企业签署《股权收购意向协议》，公司拟以现金方式收购常州维普不超过 51%股权，并实现对常州维普的控股。标的公司 100%股权的整体估值暂定为不超过人民币 10 亿元（含），本次交易对价预计不超过人民币 5.10 亿元，标的公司 100%股权的估值以及本次交易定价最终以评估报告和正式签署的收购协议为准。根据意向协议约定，本次公司收购股权意向交易对方暂不包括关联方红土一号基金及深创新资本，公司收购股权后将构成与关联方共同投资；后续正式交易中，若红土一号基金及深创新资本参与本次收购交易，本次交易可能构成关联交易。经初步测算，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

利通电子：2025年限制性股票激励计划摘要公告

公司9月1日发布公告，股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数，本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 265 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 25,993.00 万股的 1.02%。其中，首次授予 215.00 万股，占本次授予限制性股票总量的 81.13%，占当前公司股本总额的 0.83%；预留授予 50 万股，占本次授予限制性股票总量的 18.87%，占当前公司股本总额的 0.19%。

可立克：关于控股股东及一致行动人减持股份权益变动触及1%整数倍的公告

公司9月1日发布公告，深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年5月12日披露《关于控股股东及一致行动人、董事、高级管理人员减持股份预披露公告》，公司控股股东赣州盛妍投资有限公司、控股股东的一致行动人可立克科技有限公司提交的《关于减持公司股份计划告知函》，计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式或大宗交易方式共计减持不超过14,646,960股的公司股份，即不超过公司总股本的3%。公司于 2025年7月18日披露了《关于控股股东及一致行动人减持股份权益变动触及1%整数倍的公告》（公告编号：2025-060），可立克科技在2025年7月17日通过大宗交易方式合计减持本公司股份3,648,000股，占公司总股本的0.74%。本次减持后，盛妍投资及可立克科技合计持有的公司股份比例由减持前的59.69%降至58.95%。

燕东微：持股5%以上股东减持股份计划公告

公司9月02日发布公告，截至本公告日，公司持股5%以上股东北京亦庄国际投

资发展有限公司持有北京燕东微电子股份有限公司168,912,889股股票，占公司总股本的11.83%。上述股份来源为公司首次公开发行股票并上市前取得。公司5%以上股东亦庄国投因自身经营管理需要，本次拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持，将于本减持计划披露之日起15个交易日之后的三个月内减持公司股份不超过14,276,180股，本次拟通过集中竞价或大宗交易方式减持股份不超过公司总股本比例1%。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定，若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、增发新股等股份变动事项，减持股份数量进行相应调整。

水晶光电：2025年半年度权益分派实施公告

公司9月02日发布公告，公司于2025年5月8日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红方案的议案》，同意在符合利润分配相关条件的前提下，由董事会根据公司实际情况制定2025年度中期分红方案。本次半年度权益分派方案已经2025年8月27日召开的第七届董事会第二次会议审议通过。公司2025年半年度利润分配预案为：以公司现有总股本1,390,632,221股扣除公司回购专户上已回购股份14,732,555股后的总股本1,375,899,666股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，合计派发现金股利137,589,966.60元（含税）。公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。如在利润分配方案实施前，公司总股本或回购专户上已回购股份数发生变化，则以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的公司总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本总额为基数进行利润分配，分配比例保持不变，相应调整现金分红总额。

南大光电：2025年半年度权益分派实施公告

公司9月02日发布公告，公司于2025年4月24日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》，同意授权董事会根据股东会决议在满足分红条件的前提下，论证、制定并实施公司2025年度中期分红方案。公司于2025年8月25日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了2025年半年度利润分配方案：以公司现有总股本691,156,903股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），合计派发现金股利124,408,242.54元（含税）。不送红股，不进行资本公积转增股本。利润分配方案公布后至实施前，如公司总股本发生变动的，将按照“现金分红比例不变的原则”相应调整利润分配总额。

派瑞股份：关于签订战略合作协议的公告

公司9月02日发布公告，西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司与西安电力电子技术研究所有限公司签订《战略合作协议》，双方拟联合开展以中高压IGBT为代表的功率器件研发制造。本协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性的初步约定，最终能否实施尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。本协议不涉及具体交易金额，预计不会对公司本年度经营业绩产生重大影响，对公司未来年度经营业绩的具体影响存在不确定性。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，西电所为公司的关联方，公司与西电所签署《战略合作协议》事项构成关联交易，但因本协议为框架性协

议，尚未构成关联交易的实质。该事项无需提交公司董事会和股东会审议。

至纯科技：控股股东及其一致行动人减持股份计划公告

公司9月3日发布公告，控股股东蒋渊女士计划以大宗交易和集中竞价方式减持其所持有的公司股份不超过 6,000,000 股，减持数量占公司总股本的比例为 1.5640%。本次减持的实施将于本次减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行，减持价格按照减持实施时的市场价格确定。因个人资金需求，控股股东之一陆龙英女士计划以大宗交易和集中竞价方式减持其所持有的公司股份不超过 3,000,000 股，减持数量占公司总股本的比例为 0.7820%。本次减持的实施将于本次减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行，减持价格按照减持实施时的市场价格确定。同时，控股股东蒋渊女士及其一致行动人陆龙英女士将共享减持额度，通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过总股本的 1%，通过大宗交易方式减持公司股份合计不超过总股本的 2%。在减持计划实施期间，公司若发生派发红利、送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持数量和比例将进行相应调整。

传音控股：传音控股2025年半年度权益分派实施公告

公司9月3日发布公告，公司于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红的议案》，授权董事会在符合利润分配条件下，制定并实施具体的 2025 年中期利润分配方案。公司于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》。本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,140,350,575 股为基数，每股派发现金红利 0.8 元（含税），共计派发现金红利 912,280,460.00 元。

生益科技：生益科技关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

公司9月3日发布公告，广东生益科技股份有限公司于 2025 年 8 月 15 日召开第十一届董事会第九次会议和第十一届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销2024 年度限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于公司2024 年度限制性股票激励计划有 5 名激励对象因个人原因离职，根据公司《2024 年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，公司决定以自有资金回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 143,700 股。回购注销实施完毕后，公司有限售条件股份减少 143,700 股，公司总股本由 2,429,262,930 股减少至 2,429,119,230 股，第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。

濮阳惠成：2025年半年度权益分派实施公告

公司9月3日发布公告，公司董事会根据股东会授权，于2025年8月20日公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于实施2025年中期利润分配的议案》，具体内容详见公司于2025年8月22日在巨潮资讯网披露的《关于实施2025年中期利润分配的公告》。本次分派方案的具体内容为：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向权益分派实施时股权登记日的

在册股东每10股派送现金股利2元(含税)。本次利润分配不送红股,不进行资本公积金转增股本。在利润分配预案实施时公司总股本如因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变动,将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。公司权益分派具体实施前因股份回购、再融资新增股份等原因发生股本变动的,以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数(回购账户股份不参与分配),公司将按每股分配比例不变的原则,相应调整分红总额。

力合微：关于董事减持股份计划公告

公司9月04日发布公告,截至本公告披露之日,深圳市力合微电子股份有限公司董事冯震罡先生持有公司股份3,448,128股,占公司总股本比例为2.37%。上述股份来源于冯震罡先生在公司首次公开发行前持有的股份,并已上市流通。公司近日收到董事冯震罡先生出具的《股份减持计划告知函》,冯震罡先生因个人资金需求,计划自本公告发布之日起的15个交易日后至未来3个月内,通过集中竞价、大宗交易等方式减持其所持有的公司股份不超过570,000股,拟减持股份占公司总股本的比例不超过0.39%。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定,且不低于公司首次公开发行价格。若在上述减持计划实施期间公司发生派发红利、送股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项,冯震罡先生将对上述减持股份数量进行相应调整。

大为股份：2023年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期提示性公告

公司9月04日发布公告,2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件的激励对象共11名,可行权的股票期权数量共计15.1530万份,行权价格为12.409元/份。本次行权采用自主行权模式。本次激励计划首次授予股票期权共分三期行权,根据公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定,2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期为2025年8月28日至2026年8月27日止。根据行权手续办理情况,本次实际可行权期限为2025年9月5日起至2026年8月27日止。本次可行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

莱特光电：2025年第一次临时股东会决议公告

公司9月04日发布公告,本次股东会由公司董事会召集,公司董事长王亚龙先生因工作原因无法现场主持,以通讯方式出席本次会议。根据《公司章程》的相关规定,本次股东会由公司副董事长李红燕女士主持,会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》的规定。公司在任董事7人,出席7人;董事会秘书潘香婷女士出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

安克创新：2025年半年度权益分派实施公告

公司9月04日发布公告,公司于2025年8月27日召开第四届董事会第四次会议,在2024年年度股东大会授权范围内审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》,2025年半年度利润分配方案为:以权益分配前总股本536,157,605股为基数,向全体股东每10股分派现金红利7.00元(含税),预计派发现金股

利人民币375,310,323.50元(含税),预计派发现金红利总额占2025年半年度归属母公司股东的净利润为32.16%,不送红股,不进行资本公积金转增股本。在利润分配方案实施前,公司股本如发生变动,将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

维峰电子：2025年半年度权益分派实施公告

公司9月5日发布公告,公司于2025年8月21日召开第二届董事会审计委员会第十八次会议,于2025年8月22日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于2025年中期现金分红方案的议案》,董事会制定2025年半年度权益分派方案为:以截至2025年6月30日的总股本109,893,594股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),预计派发现金股利人民币21,978,718.80元,不送红股,不进行资本公积转增股本。公司权益分派具体实施前因股份回购、股权激励行权、再融资新增股份等原因发生股本变动的,以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数(回购账户股份不参与分配),公司将按每股分配比例不变的原则,相应调整分红总额。

迅捷兴：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告

公司9月5日发布公告,深圳市迅捷兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市嘉之宏电子有限公司(下称“嘉之宏”)的100%股权并募集配套资金(下称“本次交易”)。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大资产重组。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更,不构成重组上市。

ST长方：关于公开挂牌转让公司部分资产的进展公告

公司9月5日发布公告,深圳市长方集团股份有限公司于2025年8月4日召开第五届董事会第十二次会议,于2025年8月20日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了以公开挂牌方式转让公司部分资产的相关事项。同意公司将名下的坪山长方工业园和长方集团楼以资产评估值为挂牌底价在深圳联合产权交易所股份有限公司公开挂牌转让,出价最高者竞得;若首次挂牌期满未能征集到符合条件的意向受让方,公司将以不低于31,068万元的价格进行二次挂牌。若两次公开挂牌仍未能征集到符合条件的意向受让方或未能最终成交,公司将终止标的资产挂牌事宜。

国力股份：关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告

公司9月5日发布公告,经中国证券监督管理委员会出具《关于同意昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1065号)同意,昆山国力电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象共计发行可转换公司债券4,800,000张,每张债券面值为人民币100元,募集资金总额为人民币480,000,000.00元,扣除发行费用(不含增值税)13,025,471.69元后,募集资金净额为人民币466,974,528.31元。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2023]230Z0157号《验资报告》验证。

莱特光电：关于调整2025年半年度利润分配现金分红总额的公告

公司9月5日发布公告，公司于2025年8月18日召开第四届董事会审计委员会第十次会议及第四届董事会第十四次会议，于2025年9月4日召开2025年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.80元（含税），不进行资本公积金转增股本、不送红股。如在本次利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整拟分配的利润总额，并将另行公告具体调整情况。

五、下周重要事件提示

表 3：下周重要会议

行业会议				
序号	会议名称	会议时间	会议地点	主办单位
1	第 27 届集成电路制造年会暨供应链创新发展大会	9.10-9.12	深圳市	中国半导体行业协会集成电路分会
2	2025 中国国际光电博览会（CIOE）	9.10-9.12	深圳市	深圳 UBM 贺戎展览有限公司
3	2025 年计算智能与机器人国际学术会议（CIR 2025）	9.12-9.14	广州市	广东第二师范学院、华南理工大学
公司会议				
序号	公司名称	会议名称		会议时间
1	深圳华强	股东大会举办		2025-09-12
2	好上好	股东大会举办		2025-09-12
3	广合科技	股东大会举办		2025-09-12
4	雅克科技	股东大会举办		2025-09-12
5	奥拓电子	股东大会举办		2025-09-12
6	*ST 恒久	股东大会举办		2025-09-12
7	长盈精密	股东大会举办		2025-09-12
8	瑞丰光电	股东大会举办		2025-09-12
9	南大光电	股东大会举办		2025-09-12
10	香农芯创	股东大会举办		2025-09-12
11	英飞特	股东大会举办		2025-09-12
12	民德电子	股东大会举办		2025-09-12
13	百邦科技	股东大会举办		2025-09-12
14	久量股份	股东大会举办		2025-09-12
15	派瑞股份	股东大会举办		2025-09-12

16	苏州天脉	股东大会举办	2025-09-12
17	三安光电	股东大会举办	2025-09-12
18	环旭电子	股东大会举办	2025-09-12
19	晨丰科技	股东大会举办	2025-09-12
20	格林达	股东大会举办	2025-09-12
21	方邦股份	股东大会举办	2025-09-12
22	必易微	股东大会举办	2025-09-12
23	清越科技	股东大会举办	2025-09-12
24	茂莱光学	股东大会举办	2025-09-12
25	和辉光电	股东大会举办	2025-09-12
26	力合微	股东大会举办	2025-09-12
27	智新电子	股东大会举办	2025-09-12
28	风华高科	股东大会举办	2025-09-11
29	兴森科技	股东大会举办	2025-09-11
30	同兴达	股东大会举办	2025-09-11
31	捷荣技术	股东大会举办	2025-09-11
32	北京君正	股东大会举办	2025-09-11
33	贝仕达克	股东大会举办	2025-09-11
34	骏成科技	股东大会举办	2025-09-11
35	东田微	股东大会举办	2025-09-11
36	信音电子	股东大会举办	2025-09-11
37	钧崴电子	股东大会举办	2025-09-11
38	华岭股份	股东大会举办	2025-09-11
39	科森科技	股东大会举办	2025-09-11
40	世运电路	股东大会举办	2025-09-11
41	中巨芯	股东大会举办	2025-09-11
42	格科微	股东大会举办	2025-09-11
43	威贸电子	股东大会举办	2025-09-11
44	GQY 视讯	股东大会举办	2025-09-10
45	聚飞光电	股东大会举办	2025-09-10
46	珂玛科技	股东大会举办	2025-09-10
47	凤凰光学	股东大会举办	2025-09-10
48	天通股份	股东大会举办	2025-09-10
49	华勤技术	股东大会举办	2025-09-10
50	清溢光电	股东大会举办	2025-09-10
51	中船特气	股东大会举办	2025-09-10
52	峰岬科技	股东大会举办	2025-09-10
53	中微半导	股东大会举办	2025-09-10
54	美芯晟	股东大会举办	2025-09-10
55	得润电子	股东大会举办	2025-09-09
56	经纬辉开	股东大会举办	2025-09-09
57	联建光电	股东大会举办	2025-09-09

58	维峰电子	股东大会举办	2025-09-09
59	铜峰电子	股东大会举办	2025-09-09
60	汇顶科技	股东大会举办	2025-09-09
61	金宏气体	股东大会举办	2025-09-09
62	神工股份	股东大会举办	2025-09-09
63	伟测科技	股东大会举办	2025-09-09
64	安凯微	股东大会举办	2025-09-09
65	莱尔科技	股东大会举办	2025-09-09
66	盈趣科技	股东大会举办	2025-09-08
67	中晶科技	股东大会举办	2025-09-08
68	隆利科技	股东大会举办	2025-09-08
69	利安科技	股东大会举办	2025-09-08
70	海能实业	股东大会举办	2025-09-08
71	朗特智能	股东大会举办	2025-09-08
72	雅创电子	股东大会举办	2025-09-08
73	晶方科技	股东大会举办	2025-09-08
74	江化微	股东大会举办	2025-09-08
75	华体科技	股东大会举办	2025-09-08
76	帝奥微	股东大会举办	2025-09-08
77	艾森股份	股东大会举办	2025-09-08
78	普冉股份	股东大会举办	2025-09-08
79	泓禧科技	股东大会举办	2025-09-08

数据来源: Choice, 金元证券研究所

表 4: 电子行业限售股解禁情况汇总 (单位: 万股)

股票代码	公司名称	解禁日期	解禁数量	总股本	解禁前		解禁后		限售股份类型
					流通 A 股	占比 (%)	流通 A 股	占比 (%)	
688549.SH	中巨芯	2025-09-08	1,158.30	0.78	58,931.90	39.89	57,773.60	39.11	首发战略配售股份
301328.SZ	维峰电子	2025-09-08	1,638.26	14.91	5,051.68	45.97	3,413.42	31.06	首发原股东限售股份
603986.SH	兆易创新	2025-09-08	31.40	0.05	66,403.00	99.66	66,371.60	99.61	股权激励限售股份
001309.SZ	德明利	2025-09-08	61.67	0.27	16,039.17	70.69	15,977.50	70.42	股权激励限售股份
300493.SZ	润欣科技	2025-09-09	565.70	1.08	50,654.00	98.82	50,098.30	97.74	股权激励限售股份
603986.SH	兆易创新	2025-09-10	228.63	0.34	66,600.24	99.95	66,371.60	99.61	股权激励期权行权
301275.SZ	汉朔科技	2025-09-11	203.12	0.48	3,379.20	8.00	3,176.08	7.52	首发机构配售股份

数据来源: Choice, 金元证券研究所

2025 年 9 月



金元证券行业投资评级标准：

增持：行业股票指数在未来 6 个月内超越大盘；

中性：行业股票指数在未来 6 个月内基本与大盘持平；

减持：行业股票指数在未来 6 个月内明显弱于大盘。

金元证券股票投资评级标准：

买入：股票价格在未来 6 个月内超越大盘 15%以上；

增持：股票价格在未来 6 个月内相对大盘变动幅度为 5%~15%；

中性：股票价格在未来 6 个月内相对大盘变动幅度为-5%~+5%；

减持：股票价格在未来 6 个月内相对大盘变动幅度为-5%~-15%；。

免责声明

本报告由金元证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告所载资料的来源及观点的出处皆被金元证券认为可靠，但金元证券不保证其准确性或完整性。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专业财务顾问的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，金元证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。投资者需自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

本报告所载的信息、材料或分析工具仅提供给阁下作参考用，不是也不应被视为出售、购买或认购证券或其他金融工具的要约或要约邀请。该等信息、材料及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，金元证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

金元证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。金元证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。金元证券的自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

在法律许可的情况下，金元证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到金元证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

本报告的版权仅为金元证券所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式转发、翻版、复制、刊登、发表或引用。